

2008 年度精密工学会春季大会学術講演会講演募集について

1. 期 日 平成20年3月17日(月)～19日(水)
2. 会 場 明治大学 生田キャンパス(川崎市多摩区東三田 1-1-1)
3. 講演申込開始 平成19年10月11日(木) 9時 から
4. 講演申込締切 平成19年11月15日(木) 17時まで
5. 講演申込費締切日 平成20年1月31日(木) までにお納め下さい。
6. 講演論文原稿締切 平成20年1月18日(金) 17時まで
7. 講演論文公開予定 平成20年3月3日(月)(講演論文集 CD-ROM 発行)
8. 登壇資格

登壇者は個人会員(正会員・学生会員・学生会員 Web 級・名誉会員)に限ります。

・会員番号は名簿または会誌送付用封筒の宛名ラベルをご参照ください。

・未入会者で、講演希望の方は事前に入会手続きをお願い致します。会員番号が決定後、講演申し込み願います。

・登壇者を代表に申し込んでいただきますが、講演原稿での著者の順番はこれに従う必要はありません。

9. 講演申込みについて

1) 登壇者のお名前でご受け付けます。講演費用の請求、郵送物の送付は登壇者に行います。また、WEB へのアクセスも登壇者に限りますので、お申込後にやむを得ず登壇者を変更される場合は、必ずご連絡をお願い致します。

2) 講演申込みは、すべて精密工学会ホームページでご受け付けます。締切期日を厳守してください。直ちにプログラム編成を行いますので、遅れたものは理由を問わず受け付けません。なお、精密工学会ホームページには講演募集に関する最新情報を掲載します。

3) 申込先

<http://www.jspe.or.jp/> (精密工学会ホームページ)

(問合せ先) 社団法人 精密工学会 2008 年度春季大会係

〒102-0073, 東京都千代田区九段北 1-5-9 九段誠和ビル 2 階, 電話 : 03-5226-5191

4) 講演申込みは 1 件につき 1 通登録してください。

5) 講演申込みには下記の費用が必要です。

登壇者会員区分	お申込	講演費	備 考
正 会 員	1 件目	10,000 円	登壇者の大会参加費, 講演論文集 CD-ROM, アブストラクト集含む
	2 件目以降	5,000 円	_____
学生会員・学生会員 Web 級	1 件目	5,000 円	登壇者の大会参加費, アブストラクト集含む ※講演論文集 CD-ROM は別途ご購入下さい。
	2 件目以降	5,000 円	_____

送金方法 : 現金書留・郵便振替・銀行振込

郵便振替 : 00180-3-6115, 社団法人精密工学会

銀行振込 : みずほ銀行 九段支店, 普通預金, 口座番号 8047788, 社団法人精密工学会

5) 講演論文原稿は、PDF 原稿の書き方および PDF 原稿見本を参考に作成し、原稿締切日までに指定の web ページから提出してください。

6) 申し込んだ講演に対し、講演論文集原稿を期限までに提出し、著者のいずれかが会場で発表する必要があります。

7) 講演論文集および口頭発表に用いる言語は日本語または英語といたします。

8) 講演論文集 CD-ROM に収録された論文の著作権およびアブストラクト集に掲載される概要の著作権は社団法人精密工学会に帰属します。著作権には複製権、翻案権、翻訳権を含みます。

10. 講演申込の方法

1) 講演申込みは、インターネットの精密工学会ホームページでフォームに沿って登録して下さい。

2) 同一題目の第1報～第n報には必ず副題を入れてください。

3) 講演要旨はそのままアブストラクト集に収録します。講演要旨には図表は掲載できません。研究内容が把握できるわかりやすい文章を200字以内で書いてください。

JST(独立行政法人 科学技術振興機構) データベース用アブストラクトには、英文(100～200word程度)を掲載致します。講演論文については、大会終了半年後に掲載致します。

4) 分類・コード・キーワードの入力について

プログラム分類・コード・キーワードを別紙一覧表の通り設定しました。このキーワードはあくまでもセッションを構成するための「セッションキーワード」です。文献検索用のキーワードではありませんので、ご理解下さい。申込内容にふさわしい分類・コード・キーワードを選択し、所定欄に入力して下さい。オーガナイズドセッションに適切なものがない場合は分類のみを指定し、コードは「99」と入力して下さい(一般セッション)。一般セッションの場合、「キーワード」欄にはふさわしいキーワードを自由に入力して下さい。

・プログラム編成はキーワードで単純にソートされたものに基づいて行われます。

・キーワードは参加者からのご意見を反映し毎回変更される予定です。

11. 発表形式

本講演会の発表形式は、一般セッションとオーガナイズドセッションです。オーガナイズドセッションは一般セッションと同一形式です。以下のようなセッションを用意しましたので、内容にふさわしい研究発表を募集いたします。

<注意事項>

1) オーガナイズドセッションに申し込みをする場合は、希望するセッションで指定された分類・コード・キーワードを所定欄に必ず入力して下さい。入力漏れ、入力ミスがありますとご希望のセッションにまわりませんのでご注意下さい。

2) プログラム編成は、その編成権を学术交流委員会がもち、また責任をもって行います。その結果、ご希望のセッションとは異なるセッションでの発表になることがありますので、予めご承知おきください。また、プログラムは原則として変更できません。

2008年度精密工学会春季大会学術講演会セッション一覧

<分類表>

A: 設計・生産システム B: 加工技術・材料 C: メカトロニクス・知的システム
 D: 計測・品質管理 E: 医用・福祉工学 F: 技術史・教育 G: 新領域、その他

分類	コード	OS/一般	セッションテーマ	オーガナイザー	キーワード
A	1	OS	形状モデリング	鈴木 宏正 (東京大)、金井 崇 (東京大)	形状情報処理、CAD、点群、メッシュモデリング、曲線・曲面・ソリッドモデリング、CAD
A	2	OS	デジタルスタイルデザイン	青山 英樹 (慶應大)、金井 理 (北海道大)	意匠設計 (スタイルデザイン)、リバーブエンジニアリング、3次元形状モデリング技術、意匠形状評価技術
A	3	OS	生産システムのエンジニアリング (基礎・理論)	荒井 栄司 (大阪大)、樋野 励 (名古屋大)、藤井 信忠 (東京大)	スケジューリング、工程計画、新生産システム概念
A	4	OS	生産システムのエンジニアリング (応用・実践)	日比野 浩典 (機振協 技研)、谷水 義隆 (大阪府立大)、光行 恵司 (デンソー)	生産システム設計・評価、サプライチェーン、企業導入事例
A	5	OS	環境生産のためのライフサイクルエンジニアリング	高田 祥三 (早稲田大)、梅田 靖 (大阪大)、増井 慶次郎 (産総研)	環境問題、ライフサイクル設計、ライフサイクルマネジメント、環境配慮設計
A	6	OS	設計とサービス工学	下村 芳樹 (首都大東京)、新井 民夫 (東京大)	設計、設計支援、サービス、CAD
A	7	OS	モノづくりにおける最適化手法の活用	小林 正和 (豊田工業大学)、吉村 允孝 (京都大)、西脇 眞二 (京都大)	モノづくり、最適化、設計生産
A	8	OS	マイクロ生産機械システム	山中 将 (東北大)、三井 公之 (慶應大)、岡崎 祐一 (産総研)	マイクロ工作機械、マイクロファクトリー、マイクロ組立
A	99	一般	設計・生産システム一般		
B	1	OS	工作機械の高速高精度化	白瀬 敬一 (神戸大)、松原 厚 (京都大)、森本 喜隆 (宇都宮大)、家城 淳 (オークマ)	工作機械、高速主軸、高速送り、高速高精度制御
B	2	OS	高能率・高精度化のための切削工具	白杵 年 (島根大)、新谷 一博 (金沢工大)、関谷 克彦 (広島大)	切削工具、切削加工技術、切削特性
B	3	OS	多軸制御加工計測	竹内 芳美 (大阪大)	多軸制御、加工、計測、精度補正
B	4	OS	穴加工および穴形状精度の測定	甲木 昭雄 (九州大)	穴加工、ドリル、穴精度
B	5	OS	エンドミル加工技術	岩部 洋育 (新潟大)、安齋 正博 (理化学研)、水垣 善夫 (九州工大)、松村 隆 (東京電機大)	エンドミル加工、切削機構、切削性能、切削シミュレーション
B	6	OS	超精密マイクロ機械加工	竹内 芳美 (大阪大)、社本 英二 (名古屋大)、鈴木 浩文 (神戸大)	超精密加工、微細加工、超精密工作機械
B	7	OS	エコマシニング技術	中村 隆 (名古屋工大)、鈴木 康夫 (静岡大)	エコマシニング、環境対応生産、環境負荷低減技術
B	8	OS	金型生産技術	鈴木 裕 (九州工大)	金型用CAD/CAM、金型解析技術、高速高精度加工、新加工技術、金型加工技術、高硬度材加工
B	9	OS	超音波振動を援用した加工技術	鬼鞍 宏猷 (九州大)	超音波振動切削、超音波振動研削、超音波振動研磨
B	10	OS	研削現象とその機構	奥山 繁樹 (防衛大)、大橋 一仁 (岡山大)	研削現象、研削機構、加工計測、研削シミュレーション
B	11	OS	機械加工における状態監視と制御	近藤 英二 (鹿児島大)、川合 忠雄 (大阪市立大)、佐藤 昌彦 (鳥取大)	加工状態監視、研削加工モニタリング/制御
B	12	OS	超砥粒ホイールとその使用技術	呉 勇波 (秋田県立大)、福西 利夫 (アライドマテリアル)、立花 亨 (ミクロン精密)	超砥粒ホイール、ツルーイング/ドレッシング、研削、研磨
B	13	OS	cBN研削技術の新展開	市田 良夫 (宇都宮大)、東江 真一 (ものつくり大)	cBN砥粒、cBNホイール、研削性能、研削機構
B	14	OS	曲面・微細形状・機能性材料の超精密加工と計測	鈴木 浩文 (神戸大)、山形 豊 (理化学研)、閻 紀旺 (東北大)	曲面・微細加工、機能性材料、超精密加工、超精密計測
B	15	OS	ナノ表面研削/ELID研削	大森 整 (理化学研)、伊藤 伸英 (茨城大)、林 偉民 (理化学研)、片平 和俊 (理化学研)	ナノ精度、鏡面研削、ELID研削
B	16	OS	超平滑機械加工	安井 平司 (熊本大)	超平滑、切削、研削、研磨
B	17	OS	切断加工	諏訪部 仁 (金沢工大)、水野 雅裕 (岩手大)	切断、スライシング、ダイシング、割断
B	18	OS	砥粒加工の新展開	榎本 俊之 (大阪大)、北嶋 弘一 (関西大)	ポリシング・ラッピング、固定砥粒研磨加工、超精密研磨加工、メカノケミカル研磨加工、噴射加工

分類	コード	OS/一般	セッションテーマ	オーガナイザー	キーワード
B	19	OS	複合研磨	進村 武男 (宇都宮大)、川久保 英樹 (長野県工科短大)	磁場・電場援用研磨 (加工)、電気・磁気粘性流体利用加工
B	20	OS	プラナリゼーションCMPとその応用	池野 順一 (埼玉大)、土肥 俊郎 (埼玉大)、近藤 誠一 (半導体先端テクノロジーズ)	CMP、プラナリゼーション、超精密研磨、スラリー、半導体材料
B	21	OS	電気エネルギー応用加工	武沢 英樹 (工学院大)、早川 伸哉 (名古屋工大)	放電加工、電解加工、レーザ加工
B	22	OS	レーザ加工	山田 啓司 (広島大)、布引 雅之 (兵庫県立大)	レーザ加工、レーザ、微細加工、材料加工
B	23	OS	三次元造形	中本 剛 (千葉大)	三次元造形
B	24	OS	マイクロ・ナノ加工とその応用	諸貫 信行 (首都大東京)、森田 昇 (富山大)、梅原 徳次 (名古屋大)、池野 順一 (埼玉大)	微細加工、超精密加工、表面機能とその評価、トライボロジー
B	25	OS	表面処理・機能薄膜	垣内 弘章 (大阪大)、大竹 尚登 (名古屋大)、井上 尚三 (兵庫県立大)、安武 潔 (大阪大)	表面処理、機能薄膜、材料物性
B	26	OS	表面トポグラフィー	笹島 和幸 (東京工大)	表面トポグラフィー
B	27	OS	ナノ・マイクロ加工シミュレーション	稲村 豊四郎 (名古屋工大)、島田 尚一 (大阪電通大)	加工プロセスのシミュレーション
B	99	一般	加工技術・材料一般		
C	1	OS	精密・超精密位置決め	佐藤 海二 (東京工大)、大塚 二郎 (静岡理工科大)、大橋 康二 (ケーエスエス)	位置決め、制御、機構、センサ
C	2	OS	転がり機械要素	清水 茂夫 (明治大)、下田 博一 (明治大)、野口 昭治 (東京理科大)	転がり機械要素、転がり接触、転がり疲れ、転がり軸受、ボールねじ、ボールガイド、信頼性
C	3	OS	圧電アクチュエータとその応用デバイス	古谷 克司 (豊田工大)、岩附 信行 (東京工大)	圧電アクチュエータ、位置決め、機構、制御
C	4	OS	マイクロ/ナノシステム (旧マイクロメカニズム)	堀江 三喜男 (東京工大)、大平 文和 (香川大)、伊藤 高廣 (桐蔭横浜大)、中里 裕一 (日本工大)	マイクロ/ナノシステム、マイクロメカニズム、マイクロマシン、マイクロ/ナノメカニズム、MEMS/NEMS、MOEMS/NEOMS
C	5	OS	MEMS 商業化技術	澤田 廉士 (九州大)、高橋 正春 (産総研)、土屋 智由 (京都大)	MEMSデバイス、ナノインプリント、センサネットワーク
C	6	OS	スマートエンジニアリングシステムの設計・応用	古川 正志 (北海道大)、青村 茂 (首都大東京)、林 朗弘 (九州工大)	群知能、進化と学習、自律分散、複雑システム
C	7	OS	ロボティクス	青柳 誠司 (関西大)、関 啓明 (金沢大)、小方 博之 (成蹊大)	ロボティクス、メカトロニクス、センサ、アクチュエータ
C	99	一般	メカトロニクス・知的システム一般		
D	1	OS	メカノフォトンクス	大谷 幸利 (東京農工大)、吉澤 徹 (埼玉医科大)、野村 俊 (富山県立大)、新井 泰彦 (関西大)	光応用技術、形状計測
D	2	OS	表面ナノ構造・ナノ計測	桑原 裕司 (大阪大)、遠藤 勝義 (大阪大)、有馬 健太 (大阪大)	ナノファブリケーション、ナノストラクチャー、プローブ顕微鏡
D	3	OS	知的精密計測	高増 潔 (東京大)、笹島 和幸 (東京工大)、高谷 裕浩 (大阪大)、高 偉 (東北大)	知的計測
D	4	OS	画像応用と知能化システム	石井 明 (香川大)、浅野 敏郎 (広島工大)、菅 泰雄 (慶應大)	画像処理、画像応用、知能化システム、VR応用
D	99	一般	計測・品質管理一般		
E	1	OS	医用・人間工学	佐久間 一郎 (東京大)、太田 裕裕 (お茶の水女子大)、垣本 映 (職能開発大)	医用機器、福祉機器、人間共存型機器、生活支援機器
E	99	一般	医用・福祉工学一般		
F	1	OS	生産原論	河西 敏雄 (東京電機大)、池野 順一 (埼玉大)、伊藤 昌樹 (関東職能開発大)	技術者倫理、生産哲学、モノづくり、技術史、工学教育、技術伝承
F	99	一般	技術史・教育一般		
G	99	一般	新領域・その他		

1 2. 講演発表に関するお願いと注意

- 1) 同一講演者（同一登壇者）が同一テーマ種別で3件以上の講演はご遠慮ください。
- 2) 同一題目で3件以上の講演はご遠慮ください。
- 3) 講演で使用可能な機器はプロジェクタです。

＜プロジェクタ使用の方へ＞

パソコンは各自でご持参ください。設定・調整は各講演のセッション開始前をお願いします。パソコン不良に伴う講演トラブルについては、講演者の責任で対処していただくようお願いいたします。

- 4) 講演申込時の題目・登壇者の変更は原則として認めません。
- 5) 講演のキャンセルは原則として認めません。講演を申し込まれた場合は、必ず講演論文を提出し発表を行っていただきます。

※登壇者が病気や事故等のやむを得ない理由で発表出来ない場合は、連名者が代わりに発表するものとします。この点については、講演申込の前に、連名者に必ずご確認ください。

1 3. ベストプレゼンテーション賞の授賞について

特に優れた講演発表について「ベストプレゼンテーション賞」を大会実行委員長より講演者にお出しします。各セッションの座長が審査しますが、選考基準は発表技術を中心とするものです。受賞者には大会終了後、表彰状をお送りいたします。